



EPH™-300 シリーズ

タッチパネル用フォタイプ導電性銀ペースト Photolithographic Conductive Silver Paste for TSP

静電容量タッチパネル用回路技術動向

Technical Trend for Projected Capacitance Touch Screen Panel

- 狭額縁化による線幅の狭小化 Finer L/S on narrower space
- パネルの巨大化に伴う配線距離の延長 Longer electrodes for wider panel size



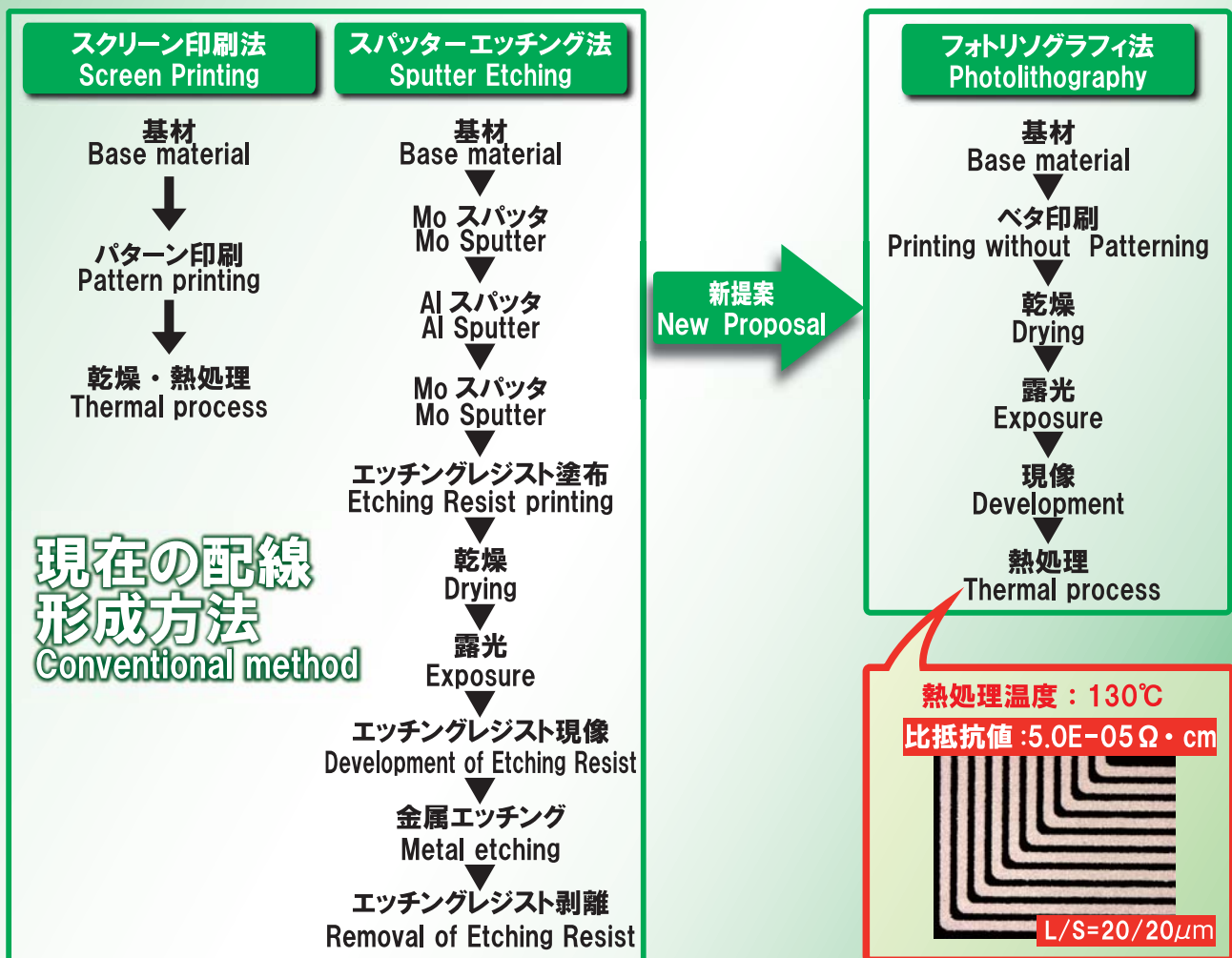
スクリーン印刷の限界 : L/S=50/50 μ m
Process Limitation of Screen Printing Method L/S=50/50



スパッターエッチング或いはフォトリソグラフィーによる配線形成へ移行
Move to Sputter Etching Method or Photolithographic Method

静電容量タッチパネル電極形成方法比較

Comparison of Electrode Patterning Methods



TAIYO INK MFG. CO., LTD.